

国际半导体展(由中国通信工业协会组织、2024年6月半导体材料展

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国际半导体展(由中国通信工业协会组织、2024年6月半导体材料展 |
| 公司名称 | 中国(耀瀚)展会信息 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 |
| 联系电话 | 17810353883 17810353883 |

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织架构

主办单位

中国通信工业协会

浙江省半导体行业协会

成都市集成电路行业协会

江苏省半导体行业协会

深圳市半导体行业协会

深圳市中新材会展有限公司

《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布，更是为半导体行业的发展指明了方向。文件中明确提出，到2030年，集成电路产业链主要环节要达到国际先进水平，一批企业要进入国际梯队。这不仅是中国半导体行业的目标，更是中国向世界科技强国迈进的坚定步伐。

为了引领半导体行业跃迁式发展，在国家各级主管部门的鼎力支持下，我们荣幸地宣布：SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会将于2024年6月26日在深圳国际会展中心（宝安新馆）盛大举行。

本次展览会致力于为参展商提供一个高端、精致、的交流平台。我们将以独到的创意、的传播策略和zhuoyue的服务，将展会提升到一个全新的高度。深圳国际会展中心（宝安新馆）将焕发出新的活力，成为半导体行业、具规模和有价值的盛会。我们诚挚邀请您共享这一行业盛宴，共谋未来发展。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会定档于2024年6月26日-6月28日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举行！为产业链的升阶发展搭建供需对接、双向奔赴的平台，探索半导体行业发展新路径，共掘半导体行业新风口！